

北京赛微电子股份有限公司
关于为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、融资租赁情况

为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）拟以部分设备资产以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，融资金额不超过3,530万元，期限不超过两年。具体内容以赛积国际与远东宏信签订的最终协议为准。

2、银行授信情况

为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司旗下子公司拟分别向北京银行股份有限公司安华路支行（以下简称“北京银行”）、宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）、中国银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度。其中公司及赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）、赛积国际拟向北京银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度，期限为1年（提款期）；赛积国际拟向宁波银行申请不超过0.5亿元的综合授信额度，期限为1年；赛莱克斯北京拟向中国银行申请不超过1亿元的综合授信额度，期限为1年，拟向宁波银行申请不超过0.5亿元的

综合授信额度，期限为1年。具体数额以相应子公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准。

公司拟为上述子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该等子公司根据资金使用计划与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，此次对外担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京赛积国际科技有限公司

1、基本情况

（1）名称：北京赛积国际科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91110115MA01RBF8Y

（3）类型：有限责任公司(法人独资)

（4）注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街1号院3号楼2层101-07室

（5）法定代表人：杨云春

（6）注册资本：88000万人民币

（7）成立日期：2020年05月19日

（8）营业期限：2020年05月19日至2050年05月18日

（9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

赛积国际为公司的全资子公司。

经查询，赛积国际不属于失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总计	113,574.59	113,004.84
负债总计	34,015.90	34,420.75
所有者权益	79,558.69	78,584.09
项目	2024年度	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	20,522.85	1,440.73
营业利润	-6,622.21	-974.60
净利润	-7,060.15	-974.60

赛积国际为公司全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。

(二) 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司

1、基本情况

(1) 名称：赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110302MA002JAU90

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

(5) 法定代表人：杨云春

(6) 注册资本：210526.32万人民币

(7) 成立日期：2015年12月15日

(8) 经营范围：半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工制造半导体器件；产品设计；销售电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

赛莱克斯北京为公司控股子公司。

经查询，赛莱克斯北京不属于失信被执行人。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总计	325,513.32	336,069.50
负债总计	190,413.04	208,980.07

所有者权益	135,100.27	127,089.43
项目	2024 年度	2025 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	26,233.86	7,933.73
营业利润	-31,164.65	-14,375.13
净利润	-24,187.86	-8,010.85

赛莱克斯北京为公司控股子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，偿还能力具有保障。

三、担保的主要内容

赛积国际拟以部分设备资产以售后回租方式与远东宏信进行融资租赁交易，融资金额不超过 3,530 万元；公司及赛莱克斯北京、赛积国际拟向北京银行申请合计不超过 1 亿元的综合授信额度；赛积国际拟向宁波银行申请不超过 0.5 亿元的综合授信额度；赛莱克斯北京拟向中国银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，拟向宁波银行申请不超过 0.5 亿元的综合授信额度。上述金额均用于子公司日常经营、项目建设及业务拓展。

公司拟为上述子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该等子公司根据资金使用计划与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

四、董事会意见

本次担保对象赛莱克斯北京为公司控股子公司，公司合计持有其 71.5% 股权，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。赛莱克斯北京的第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司未按持股比例提供同比例担保。

国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立于 2014 年 9 月，出资人包括财政部、国开金融、中国烟草等单位，主要运用多种形式对集成电路行业内企业进行投资，充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业；国家集成电路产业基金同时是公司及控股子公司赛莱克斯北京的第二大股东，一直支持公司半导体业务的发展，其受限于章程条款的约束，无法为公司控股子公司赛莱克斯北京的本次申请银行授信提供担保。

董事会认为：赛积国际本次开展融资租赁业务、赛积国际及赛莱克斯北京向银行申请综合银行授信均有利于日常生产经营及业务拓展，公司为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供连带责任担保有利于子公司筹措资金，满足其经营活动对资金的需求。赛积国际为公司全资子公司，赛莱克斯北京为公司控股子公司，均具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供担保，担保有效期限以该等子公司与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为合并报表范围内的担保。公司及子公司（含本次）的累计担保金额为 159,130.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.32%，实际担保余额为 110,526.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.45%；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日